



## 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年2月6日

上場取引所 東

上場会社名 アピックヤマダ株式会社

コード番号 6300 URL <http://www.apicyamada.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押森広仁

問合せ先責任者 (役職名) 取締役企画部長 (氏名) 小出 篤 TEL 026-275-2111

四半期報告書提出予定日 平成29年2月13日 配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無：無

四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成29年3月期第3四半期の連結業績（平成28年4月1日～平成28年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計） (%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第3四半期	7,443	14.4	△217	—	△182	—	△217	—
28年3月期第3四半期	6,505	△17.4	△520	—	△464	—	△463	—

(注) 包括利益 29年3月期第3四半期 △457百万円 (—%) 28年3月期第3四半期 △552百万円 (—%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
29年3月期第3四半期	△17.49	—
28年3月期第3四半期	△37.31	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
29年3月期第3四半期	11,873	3,869	32.6	311.59
28年3月期	12,497	4,327	34.6	348.44

(参考) 自己資本 29年3月期第3四半期 3,869百万円 28年3月期 4,327百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
28年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
29年3月期	—	0.00	—	—	—
29年3月期(予想)	—	—	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

### 3. 平成29年3月期の連結業績予想（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	12,000	10.1	320	130.2	350	57.7	300	566.7	24.15

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無  
新規 一社 （社名） 、除外 一社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料P. 3「2. サマリー情報（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	29年3月期3Q	12,969,000株	28年3月期	12,969,000株
② 期末自己株式数	29年3月期3Q	549,573株	28年3月期	548,510株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	29年3月期3Q	12,419,951株	28年3月期3Q	12,421,179株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きは終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手できる情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績の予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 2「1. 当四半期に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項 .....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	3
(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	3
3. 四半期連結財務諸表 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(セグメント情報等) .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

## (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間(平成28年4月1日～平成28年12月31日)における世界経済は、米国の内需の底堅さなどから景気回復が続いておりましたが、英国のEU脱退決定や欧米における新リーダーの誕生等内向きの政治リスク、地政学的リスクが高まり、中国などの新興国においては、一時期の急激な景気冷え込みリスクは脱したものの、投資、消費とも牽引役の不足に伴う経済成長率の鈍化が懸念されています。一方、わが国経済も、企業収益は及び雇用環境の回復により、穏やかな回復基調で推移しましたが、世界経済の下振れリスク等により、先行き不透明な状況が続いています。

当社グループの主たる供給先である半導体業界は、企業のデータセンター向けやスマートフォンの高機能化によるメモリ関連の需要増加等から設備投資が拡大しています。

こうした環境の中で、当社が開発したWLP(ウェハーレベルパッケージ)用コンプレッションモールド装置である「WCM-300L」がスマートフォンの主要半導体のモールドプロセスに採用され量産寄与するなかで、唯一の量産実績のある装置として評価をいただき、多くの半導体メーカーより引合い、受注を頂いております。また、当社グループはWLPをはじめとする先端パッケージ分野及び車載向けパッケージ分野など、当社の強みを活かした分野に対して新規製品の開発を積極的に行いました。

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は7,443百万円(前年同四半期比14.4%増)、営業損失は217百万円(前年同四半期は営業損失520百万円)、経常損失は182百万円(前年同四半期は経常損失464百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は217百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失463百万円)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

## ①電子部品組立装置

電子部品組立装置の受注環境は高機能スマートフォンの需要等の影響により、WLPを始めとする新規パッケージ向けモールド装置を中心に需要が高まり、計画どおりの受注の動きとなりました。一方、先期同様に納期が第4四半期に集中したことを主因に売上は計画を下回りました。また、利益は新規開発装置等が集中したことからコストが嵩みましたが、利益率の高い装置の売上が前年同四半期に比し構成比が高かったことを主因に大幅に改善しました。

この結果、売上高は6,245百万円(前年同四半期比33.9%増)、セグメント利益は352百万円(前年同四半期比320.8%増)となりました。

## ②電子部品

一般半導体リードフレーム等の製造につきましては、価格面で厳しい環境が継続しております。また、LEDブリモールド基板事業は、新規顧客開拓及び合理化によるコスト削減を推進しましたが、LED市場の停滞によりLEDリードフレームを含めて受注回復が遅れました。なお、リードフレーム事業において、前年同四半期は、一部の製品で当社の外注加工費用を含む取引がありましたが、商流変更により第3四半期連結累計期間は外注加工費用を除く取引となっております。この商流変更により売上は200百万円程度減少しました。

この結果、売上高は840百万円(前年同四半期比27.8%減)、セグメント損失は144百万円(前年同四半期はセグメント損失233百万円)となりました。

## ③その他

その他につきましては、リード加工金型及びリードフレーム用生産金型の販売であります。リードフレームを使用する半導体の設備投資につきましては依然慎重であり、また、リード加工金型は当面の需要の一巡感もあることから低調に推移しました。

この結果、売上高は356百万円(前年同四半期比47.2%減)、セグメント利益は21百万円(前年同四半期比75.9%減)となりました。

## (2) 財政状態に関する説明

## (資産)

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、11,873百万円(前連結会計年度末は12,497百万円)となり、前連結会計年度末と比較して623百万円減少いたしました。これは主に、棚卸資産が増加したものの、現金及び預金の減少並びに固定資産の減少によるものであります。

## (負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、8,003百万円(前連結会計年度末は8,169百万円)となり、前連結会計年度末と比較して165百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び未払金並びに長期借入金の減少によるものであります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は、3,869百万円（前連結会計年度末は4,327百万円）となり、前連結会計年度末と比較して減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上による利益剰余金の減少及び為替換算調整勘定の赤字幅の拡大によるものであります。

なお、これらの要因により、自己資本比率は32.6%（前連結会計年度末は34.6%）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期業績予想につきましては、平成28年5月13日の「平成28年3月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる損益に与える影響はありません。

(3) 追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を第1四半期連結会計期間から適用しております。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,460,611	2,204,427
受取手形及び売掛金	3,354,706	3,437,663
商品及び製品	469,776	444,643
仕掛品	1,894,673	2,570,429
原材料及び貯蔵品	121,654	266,450
その他	130,181	178,568
貸倒引当金	-	△510
流動資産合計	9,431,603	9,101,672
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	908,170	801,254
機械装置及び運搬具(純額)	357,452	296,585
土地	488,099	484,534
その他	196,225	173,538
有形固定資産合計	1,949,948	1,755,913
無形固定資産	81,872	69,719
投資その他の資産		
その他	1,038,567	950,422
貸倒引当金	△4,798	△4,436
投資その他の資産合計	1,033,769	945,985
固定資産合計	3,065,589	2,771,617
資産合計	12,497,193	11,873,290
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,761,123	2,601,891
短期借入金	3,162,000	3,500,000
1年内返済予定の長期借入金	244,448	155,942
未払法人税等	36,930	11,056
賞与引当金	102,597	56,055
製品保証引当金	86,275	89,905
その他	517,206	495,402
流動負債合計	6,910,582	6,910,252
固定負債		
長期借入金	318,010	216,400
退職給付に係る負債	731,509	701,124
その他	209,294	175,763
固定負債合計	1,258,813	1,093,288
負債合計	8,169,395	8,003,541

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,837,500	5,837,500
利益剰余金	△1,191,787	△1,409,035
自己株式	△100,944	△101,247
株主資本合計	4,544,768	4,327,216
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△5,229	18,343
為替換算調整勘定	△187,966	△459,555
退職給付に係る調整累計額	△23,773	△16,255
その他の包括利益累計額合計	△216,970	△457,467
純資産合計	4,327,797	3,869,748
負債純資産合計	12,497,193	11,873,290

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
売上高	6,505,021	7,443,257
売上原価	5,323,111	5,906,760
売上総利益	1,181,910	1,536,496
販売費及び一般管理費	1,702,010	1,754,254
営業損失(△)	△520,100	△217,758
営業外収益		
受取利息及び配当金	3,724	3,566
為替差益	16,260	48,839
受取技術料	9,692	6,458
受取賃貸料	12,903	17,972
受取補償金	46,093	-
その他	31,807	25,213
営業外収益合計	120,482	102,050
営業外費用		
支払利息	56,335	56,022
持分法による投資損失	2,901	2,730
その他	5,886	8,522
営業外費用合計	65,123	67,274
経常損失(△)	△464,741	△182,982
特別利益		
固定資産売却益	2,268	1
関係会社出資金売却益	10,422	-
特別利益合計	12,690	1
特別損失		
固定資産売却損	-	662
減損損失	-	※ 22,000
特別損失合計	-	22,662
税金等調整前四半期純損失(△)	△452,050	△205,643
法人税、住民税及び事業税	7,524	8,162
法人税等調整額	3,799	3,442
法人税等合計	11,323	11,605
四半期純損失(△)	△463,374	△217,248
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△463,374	△217,248



(四半期連結包括利益計算書)  
(第3四半期連結累計期間)

(単位:千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)
四半期純損失(△)	△463,374	△217,248
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△14,557	23,573
為替換算調整勘定	△36,230	△157,331
退職給付に係る調整額	7,430	7,518
持分法適用会社に対する持分相当額	△45,459	△114,256
その他の包括利益合計	△88,816	△240,497
四半期包括利益	△552,191	△457,745
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△552,191	△457,745

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(四半期連結損益計算書関係)

※ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	場所	種類	金額 (千円)
事業用資産	アピックヤマダ株式会社 吉野工場	建物、機械装置、土地等	22,000

当社グループは、事業用資産については、工場ごとにグルーピングしております。

事業用資産のうち、電子部品事業に供している吉野工場について収益環境が悪化したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少価額を減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物3,281千円、機械装置及び運搬具8,606千円、土地3,564千円、リース資産5,487千円、その他固定資産1,059千円であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、処分価額又は鑑定評価額であります。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他(注)	
売上高				
外部顧客への売上高	4,664,901	1,164,262	675,858	6,505,021
セグメント間の内部売上高又は振替高	19,350	7,644	121,935	148,931
計	4,684,251	1,171,906	797,794	6,653,953
セグメント利益又はセグメント損失(△)	83,831	△233,310	90,584	△58,894

(注) 「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該当差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	△58,894
セグメント間取引高消去	-
全社費用(注)	△461,206
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△520,100

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  
該当事項はありません。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			合計
	電子部品 組立装置	電子部品	その他(注)	
売上高				
外部顧客への売上高	6,245,843	840,537	356,875	7,443,257
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,487	6,494	262	9,244
計	6,248,331	847,032	357,138	7,452,501
セグメント利益又はセグメント損失(△)	352,805	△144,964	21,790	229,631

(注) 「その他」の区分は、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該当差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	229,631
セグメント間取引高消去	-
全社費用(注)	△447,389
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△217,758

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントの変更等に関する事項

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

「会計方針の変更」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間に「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる報告セグメントの利益又は損失に与える影響はありません。

4. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「電子部品」セグメントにおいて固定資産の減損損失を計上しております。尚、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては22,000千円であります。